

## Vom Wafer zum Endprodukt in weniger als 8 Wochen

- exceet Gesellschaft AEMtec erweitert Portfolio und bietet jetzt Microchipbestückung aus einer Hand
- Wettbewerbsvorteile für Kunden durch räumliche Nähe zum Hersteller
- Verkürzte Produktionszeit aufgrund modernster Fertigungsanlagen und umfassender praktischer Erfahrung

**Rotkreuz, Berlin, 18. Okt. 2016 – Die AEMtec GmbH, ein Unternehmen der internationalen Technologiegruppe exceet, hat die Wertschöpfungskette in der Microchipbestückung erweitert. Der erfahrene Elektronikspezialist mit eigener Reinraumfertigung bietet Kunden am Standort Berlin jetzt alle Fertigungsschritte vom Rohprodukt Wafer bis hin zur fertig bestückten Leiterplatte innerhalb von weniger als 8 Wochen aus einer Hand.**

Die verkürzte Produktionszeit ermöglicht den Kunden der AEMtec erhebliche Wettbewerbsvorteile im schnelllebigen und von innovativen Technologien getriebenen Microchip Markt. Insbesondere Unternehmen, die kleine und mittlere Produktionsmengen benötigen, profitieren von dem Portfolio aus einer Hand und der verkürzten Lieferzeit. Ein weiterer Pluspunkt sind die abgestimmten Verfahren mit dem Design House und Waferhersteller in der Produktion. Die außerordentliche Reduktion der Durchlaufzeiten wird durch die konsequente Vermeidung von Schnittstellenverlusten ermöglicht. Sie können von AEMtec auf ein Minimum reduziert werden. Dies wird durch die kurzen internen Abstimmungszeiten, schnellen und unkomplizierten Testläufe und nicht zuletzt Vermeidung jeglicher unnötiger Transportzeiten zwischen den Produktionsschritten erreicht.

Zusätzlich profitiert der Kunde von der optimalen Rückverfolgbarkeit der Produkte. Da ein einziger Lieferant die Verantwortung für die komplette Produktionskette und Qualität übernimmt, können mögliche Fehler schnell erkannt und beseitigt werden. Gleichzeitig kann umgehend der Produktionsprozess entsprechend justiert und verbessert werden.

### **Modernste Produktionsanlagen und Fraunhofer Lizenz**

Im Rahmen der erweiterten Wertschöpfungskette bietet AEMtec alle Schritte von der UBM (Under Bump Metallization) über das Balling und das Sägen der Wafer bis hin zum Assembly von Flip Chip in Löttechnologie und Testing. Von Vorteil für die Kunden ist zudem, dass AEMtec auch die einzelnen Produktionsschritte durch Einsatz modernster Fertigungstechnologien optimiert hat. Die Ballingprozesse erfolgen im Haus so wie die automatisierte optische Kontrolle und Reparatur. Ähnliche Optimierungen entstehen auch durch die sehr enge Zusammenarbeit von AEMtec mit IZM Fraunhofer, dem Erfinder der maskenlosen UBM, im Bereich von Electroless Plating und der UBM. Diese erfolgt gänzlich ohne individuelle, kosten- und zeitaufwändige Masken. „Mit der Erweiterung der Wertschöpfungskette festigen und bauen wir unsere Position

als Spezialist in der qualitativ anspruchsvollen Microchipbestückung konsequent weiter aus“, so Dan Negrea, Geschäftsführer der AEMtec GmbH, Berlin. „Gerade der Zielgruppe der Kunden, die kleine und mittlere Produktionsvolumen benötigen, können wir zu einer wesentlich schnelleren Time-to-Market verhelfen, und sie variantenreicher bedienen. So erzielen wir eine außergewöhnliche Kombination aus langjähriger Erfahrung, Innovationsstärke und Produktionsgeschwindigkeit in einem“.

**Ihr AEMtec Direktkontakt:**

Thomas John, Sales Director, Tel. +49 (0)151 142 60 763

Email: [thomas.john@aemtec.com](mailto:thomas.john@aemtec.com) – [www.aemtec.com](http://www.aemtec.com)

**Bildmaterial anbei und auf Anfrage verfügbar****Über exceet Group**

exceet ist eine internationale Technologiegruppe, die sich auf die Entwicklung und Fertigung intelligenter, komplexer und sicherer Elektronik spezialisiert hat.

**Über AEMtec GmbH**

AEMtec, mit Firmensitz und Fertigungsstätte am renommierten Wissenschafts- und Technologiestandort Berlin Adlershof, bietet modernste Technologien für kundenspezifische komplexe (opto-) elektronische Anwendungen. Das Unternehmen verfügt über ein breites Spektrum an High-end Chip-level-Technologien, wie Wafer Back-End Prozesse, Chip on Board, Flip Chip, 3D-Integration und Opto-Packaging. Umfangreiche Entwicklungsdienstleistungen im Bereich Machbarkeitsstudien zur Aufbau- und Verbindungstechnik, Design und Layout sowie Testequipment-Erstellung bis hin zur Serienproduktion runden das Dienstleistungsspektrum ab.

**Kontakt**

exceet Group AG

Riedstrasse 1

CH-6343 Rotkreuz

Judith Balfanz, Editorial Director

Tel. +49 (0)173 – 29 11 389

[judith.balfanz@exceet.ch](mailto:judith.balfanz@exceet.ch) / [www.exceet.ch](http://www.exceet.ch)